

证券代码：688172

证券简称：燕东微

公告编号：2025-033

北京燕东微电子股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京燕东微电子股份有限公司 2024 年年度利润分配预案为：不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

一、利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，燕东微合并报表中当年实现归属于上市公司股东的净利润为 -178,115,909.79 元，期末累计可供分配利润为 1,260,154,313.49 元。

由于公司 2024 年度净利润为-219,074,298.37 元，未实现盈利，为保障公司正常经营和未来发展，本年拟不进行利润分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的说明

报告期内，燕东微年度净利润为-219,074,298.37 元，母公司累计未分配利润为 135,250,227.10 元，燕东微拟不进行利润分配。具体原因如下。

（一）公司所处行业情况及特点

公司属于“制造业”中的“计算机、通信和其他电子设备制造业”，是一家集芯片设计、晶圆制造和封装测试于一体的高新技术企业，经过三十余年的积累，

公司已经发展成为国内知名的集成电路及分立器件制造和系统方案提供商。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司产品与方案板块主要采用 IDM 经营模式，即自身体系内包含芯片设计、晶圆制造、封装测试中全部或主要业务环节，并通过经营上述环节最终为客户提供具体的产品与解决方案，主要产品包括分立器件及模拟集成电路、高稳定集成电路及器件；制造与服务板块业务主要是公司接受其他半导体企业委托，提供晶圆制造或封装测试环节的专业化服务。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-178,115,909.79 元。公司总投资金额 75 亿元的 65nm 12 英寸晶圆生产线项目以及总投资金额 330 亿元的北电集成 12 英寸集成电路生产线项目均处于建设期，资金需求较大。

（四）公司现金分红水平较低的原因

公司 2024 年经营业绩亏损，公司投资建设 65nm 12 英寸晶圆生产线项目、北电集成 12 英寸集成电路生产线项目，2025 年资金投入较大，结合公司经营计划，2024 年度拟不进行利润分配。

（五）上市公司留存未分配利润的确切用途

结合公司经营计划，公司留存未分配利润将继续投入仍处于建设期的重点产业化项目建设，同时进一步优化 8 英寸、12 英寸晶圆生产线资源配置。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于审议 2024 年年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案。

（二）监事会意见

公司全体监事认为：公司 2024 年年度利润分配预案符合有关法律、法规关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，符合公司发展需求。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司目前总体运营情况、公司发展阶段、以及未来的资金需求与股东投资回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影

响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京燕东微电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日